

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2024-078

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——(2023年12月修订)》及相关格式指引的要求，现将杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2345号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券3,390.00万张，每张面值100元，共计募集资金人民币339,000.00万元，扣除承销和保荐费用(含税)1,060.00万元后的募集资金337,940.00万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年11月18日汇入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转换公司债券发行承销保荐费及其他发行费用(不含税)共计人民币1,187.59万元，本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用(不含税)后募集资金净额为人民币337,812.41万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年11月18日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7581号)。

(二) 募集资金使用计划

序号	项目名称	建设地点	总投资金额 (万元)	使用募集资金 (万元)	项目实施主体
1	年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目	衢州	230,233.00	113,000.00	金瑞泓微电子(衢州)有限公司
2	年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅抛光片项目	衢州	139,812.00	125,000.00	金瑞泓科技(衢州)有限公司
3	补充流动资金		101,000.00	101,000.00	
合计			471,045.00	339,000.00	

公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，部分将以增资形式投资到各项目实施主体。增资事项如涉及关联交易的，将按照届时中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》等关于关联交易的规定履行必要的审议批准和信息披露程序。

(三) 募集资金使用情况及结余情况

2022 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 102,236.51 万元，募集资金支付发行费用 127.59 万元。

2023 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 74,726.96 万元。

2024 年半年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 51,718.49 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额(含利息收入扣除银行手续费的净额)为 112,236.91 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司

制定了《杭州立昂微电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同主承销商东方证券承销保荐有限公司分别与宁波银行股份有限公司杭州城东支行、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、招商银行股份有限公司衢州分行签订了相关的募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《立昂微关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》(公告编号：2022-090)。相关的募集资金监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券有 5 个募集资金专户和 2 个募集资金保证金户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	账户名称	存储余额	备注
宁波银行股份有限公司 杭州城东支行	71060122000594365	募集资金 专户	杭州立昂微电子 股份有限公司	3,193,376.60	-
宁波银行股份有限公司 杭州城东支行	71060122000594421	募集资金 专户	金瑞泓微电子 (衢州)有限公司	682,008,615.87	-
招商银行股份有限公司 衢州分行	571900276410809	募集资金 专户	杭州立昂微电子 股份有限公司	3,610,964.58	-
招商银行股份有限公司 衢州分行	570900397310808	募集资金 专户	金瑞泓科技(衢 州)有限公司	155,619,041.69	-
兴业银行股份有限公司 宁波北仑支行	388010100101880777	募集资金 专户	杭州立昂微电子 股份有限公司	158,589.74	-
招商银行股份有限公司 衢州分行	57090039731100012	募集资金 保证金户	金瑞泓科技(衢 州)有限公司	243,415,500.89	-
宁波银行股份有限公司 杭州分行	7108009900007663500 0001	募集资金 保证金户	金瑞泓微电子 (衢州)有限公司	34,363,050.10	-
合 计				1,122,369,139.47	

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为 337,812.41 万元。按照募集资金用途，计划用于“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”等三个项目，项目投资总额为 471,045.00 万元，拟投入募集资金金额为 339,000.00 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，前述项目实际已投入募集资金为 228,681.96 万元。

使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司 2022 年 12 月 16 日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 16,099.06 万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2022]7724 号)。上述募集资金已于 2022 年 12 月 27 日全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2023 年度，公司使用 45,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专用账户。

2024 年半年度，公司使用 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金已提前归还至募集资金专用账户。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司本期不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目已于 2023 年 12 月建设完毕，节余募集资金在本报告期已永久补充流动资金。具体详见公司于 2023 年 12 月 14 日、2024 年 6 月 1 日分别在上海证券交易所披露的《立昂微关于 2021 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2023-089）、《立昂微关于 2021 年非公开发行股票募集资金专户注销的公告》

(公告编号 2024-061)。

(八) 募集资金使用的其他情况。

2024年4月22日公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，对发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”和“年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目”进行延期，同意将前述募集资金投资项目的建设期由2024年5月延长至2026年5月。具体详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所披露的《立昂微关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号2024-046)。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：杭州立昂微电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		339,000.00		本年度投入募集资金总额		51,718.49						
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		228,681.96						
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2) [注1]	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产180万片12英寸半导体硅外延片项目	-	113,000.00	113,000.00	未做分期承诺	22,301.99	42,478.28	不适用	37.59	2026年5月[注2]	不适用	不适用	否
年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目	-	125,000.00	125,000.00	未做分期承诺	29,416.50	86,229.28	不适用	68.98	2026年5月[注2]	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	101,000.00	101,000.00	未做分期承诺	0.00	99,974.40	不适用	98.98	不适用			否
合计		339,000.00	339,000.00		51,718.49	228,681.96		67.46				
未达到计划进度原因				受外部宏观经济环境影响，公司所处行业市场景气度偏弱，导致市场需求下降，公司部分募集资金投资项目建设进度有所延迟，整体建设进度未达预期。结合相关项目建设的实际情况及未来业务发展的规划，经审慎研究，2024年4月22日公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，对发行可转换公司债券募集资金投资项								

	目“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”和“年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅抛光片项目”进行延期，同意将前述募集资金投资项目的建设期由 2024 年 5 月延长至 2026 年 5 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。未来公司将加快募投项目的建设进度，以保障募投项目顺利实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司 2022 年 12 月 16 日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 16,099.06 万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2022]7724 号)。上述募集资金已于 2022 年 12 月 27 日全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024 年半年度，公司存在使用 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本期归还暂时补充流动资金 60,000.00 万元的情况。截止 2024 年 6 月 30 日，公司暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1] 公司 2022 年 11 月发行可转债募集资金投资项目截至 2024 年 6 月 30 日募集资金累计投入金额 228,681.96 万元,该金额不包含已支付的发行费用 1,187.59 万元。

[注 2] 受外部宏观经济环境影响，公司所处行业市场景气度偏弱，导致市场需求下降，公司部分募集资金投资项目建设进度有所延迟，整体建设进度未达预期。结合相关项目建设的实际情况及未来业务发展的规划，经审慎研究，2024 年 4 月 22 日公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，对发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”和“年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅抛光片项目”进行延期，同意将前述募集资金投资项目的建设期由 2024 年 5 月延长至 2026 年 5 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。未来公司将加快募投项目的建设进度，以保障募投项目顺利实施。